

表面実装型製品の半田リフロー及びテーピング

COB

CHIP ON BOARD

FEATURE	特徴	特徴
◆ Possible total costdown from IC package to COB	◆ 从IC封装变更为COB可以降低成本	◆ IC PACKAGEをCOB化する事によりトータルコストダウンが可能
◆ No need change PCB board	◆ 不需要变更基板	◆ IC PACKAGEとPIN互換の小基板にモールドングするため基盤変更が不要
◆ RoHS compliant product	◆ 符合RoHS要求	◆ RoHS指令に適合しています

SPECIFICATIONS 規格

ITEM	項目	Unit 单位単位	Standard 标准值 標準値	Min.最小値最小値	Remarks 备注 備考
Bonding wire 帮定线 ボンディングワイヤー		um	φ 32		AJ wire 帮线 AIワイヤー
PCB pitch 基板间距 基板ピッチ		mm			
IC Pad pitch IC垫间距 IC PADピッチ		um		0.65	
IC Pad size IC垫尺寸 IC PADサイズ		um	90	100	
PCB thickness 基板厚度 基板厚		mm	0.6	80	
Resin height 树脂高度 封止高		mm	1.4		
Total height 全高 全高		mm	2		
PCB material 基板材料 基板材質			FR4		other material can be use 其它材料可用 材料請洽本公司
Resin 树脂 封止剂			Use our standard or customer requirement 使用我们的标准或客户指定 当社標準 またはお客様指定		

COB Line UP COB ラインナップ

30Pin 0.65mm Pitch 10.0mmx7.8mm	34Pin 0.65mm Pitch 11.7mmx9.3mm	64Pin 0.65mm Pitch 13.8mmx13.8mm	100Pin 0.65mm Pitch 23.9mmx17.9mm
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

